香合佛

阿弥陀如来立像（来迎）

修復報告書

平成 27 年 6 月 12 日

巧匠堂

香合佛　阿弥陀如来立像（来迎）　　修復報告書

作成日：2015 年 6 月 12 日

委　託　者	：	関川鶴祐
修復責任者	：	吉水快聞
施　工　者	：	吉水快聞
修復期間	：	平成 27 年 6 月
目　的	：	欠損部の接合及び尊容回復
制作年代	：	不明
寸　法	：	像底～像頂　18㎜　像幅　6.3㎜ 総高（雲座～光背の頂）33㎜　総幅 22.5㎜ 香合直径 43.9㎜
材　質	：	白檀か　彩色　截金
内　容	：	欠損部及び脱落部の接合 欠失部の補作など

修復前

修復過程

□全解体修復

本体：遊離した両手先の接合

蓮華座：上段当初部材・下段欠失した蓮弁を白檀を用いて新補

光背：欠損部を接合し、欠失部を白檀を用いて新補。頭光のガラス裏面の銀箔と当紙は劣化の為交換

修復が完了し組み上げる前の部材

修復前写真（本体）